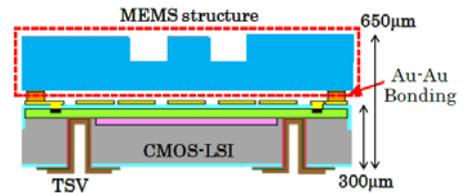
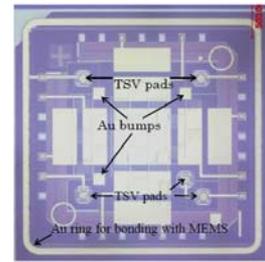
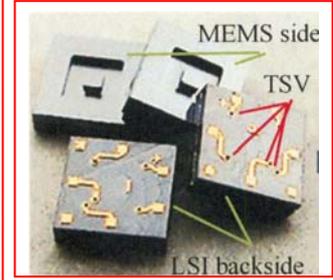
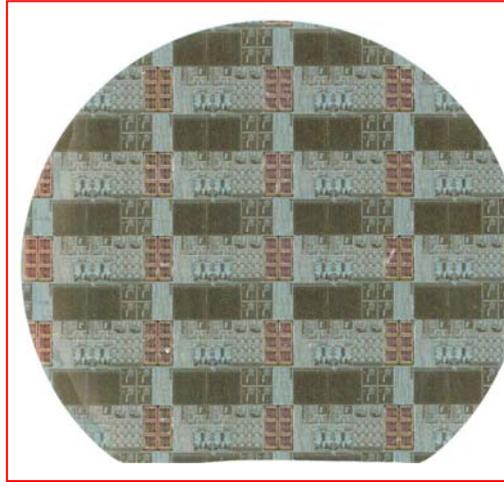
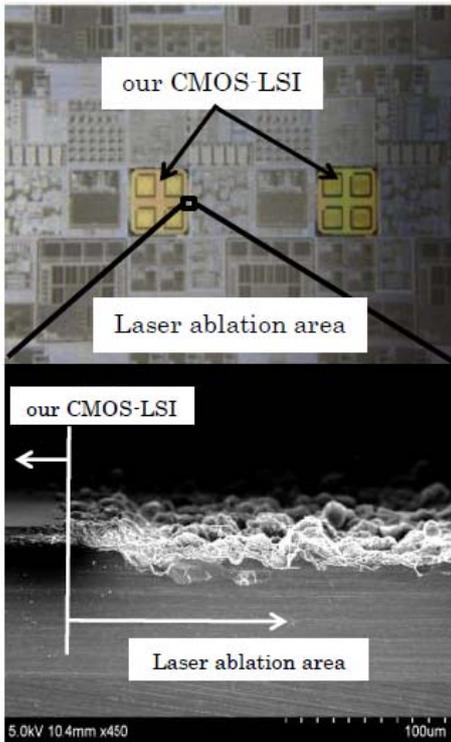
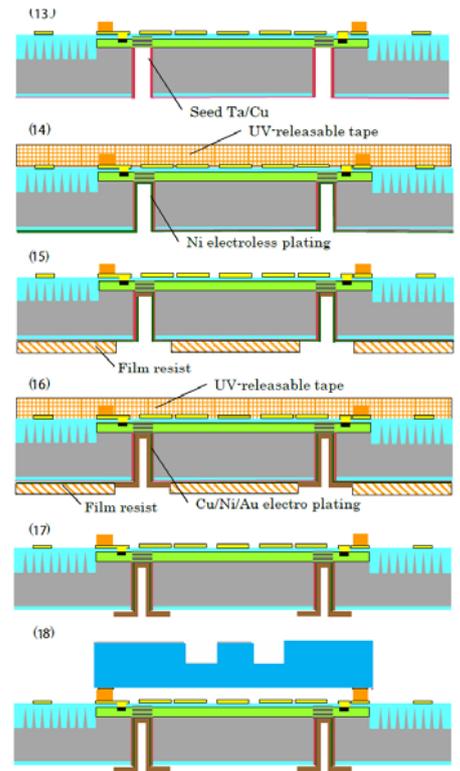
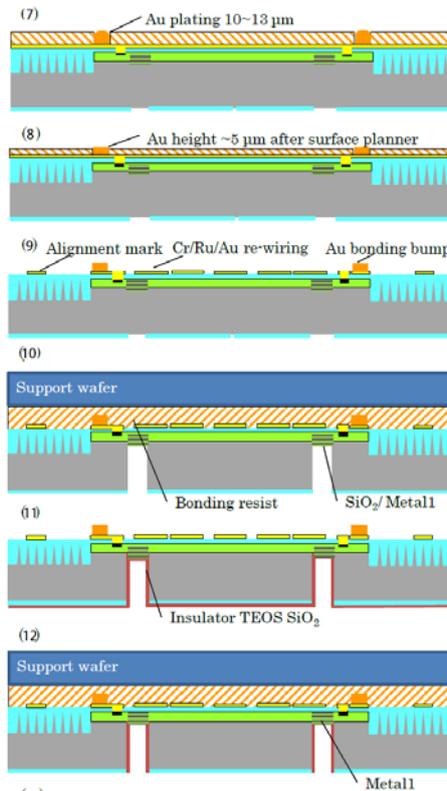
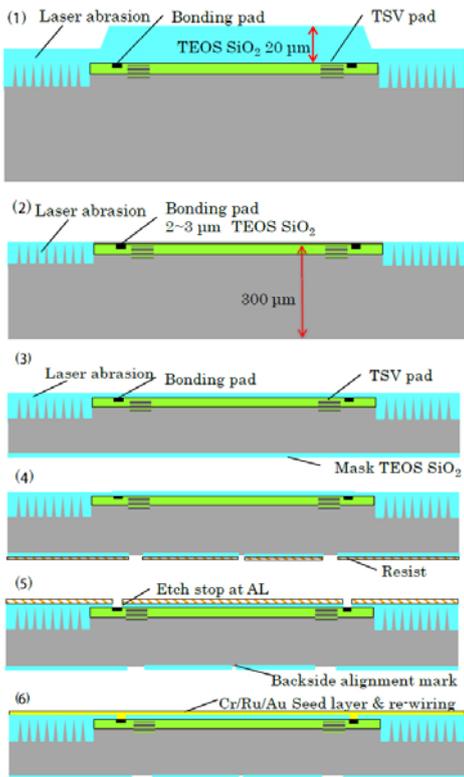


レーザ消去ウェハプロセス



不特定のユーザと共用するため他のチップをレーザ消去したマルチプロジェクト CMOSLSI ウェハへの MEMS と TSV を形成 触覚センサネットワークチップへの応用



製作工程

(鈴木裕輝夫、田中秀治 他、表面実装型集積化 MEMS のためのレーザ消去 CMOS-LSI マルチプロジェクトウェハへの深い TSV の作製、Sensor Symp. 2016, 24pm2-B-6)